

公司代码：603005 公司简称：晶方科技

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2018 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018 年度公司的利润分配方案为：以公司总股本 234,191,955 股为基数（最终以利润分配股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 16,393,436.85 元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。本预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	晶方科技	603005	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	段佳国	胡译
办公地址	苏州工业园区汀兰巷29号	苏州工业园区汀兰巷29号
电话	0512-67730001	0512-67730001
电子信箱	info@wlcsp.com	info@wlcsp.com

2 报告期公司主要业务简介

1、公司主营业务：公司专注于传感器领域的封装测试业务，拥有多样化的先进封装技术，同时具备 8 英寸、12 英寸晶圆级芯片尺寸封装技术规模量产封装能力，为全球晶圆级芯片尺寸封装服务的主要提供者与技术引领者。封装产品主要包括影像传感器芯片、生物身份识别芯片、微机电系统芯片（MEMS）、环境光感应芯片、医疗电子器件、射频芯片等，该等产品广泛应用在消费电子

（手机、电脑、照相机、游戏机）、安防监控、身份识别、汽车电子、虚拟现实、智能卡、医学电子等诸多领域。

2、公司经营模式：集成电路行业主要包括芯片设计、晶圆制造、封装测试几个主要环节。公司为专业的集成电路封测服务提供商，业务模式为客户提供晶圆或芯片委托封装，公司根据客户订单制定月度生产任务与计划，待客户将需加工的晶圆发到公司后，由生产部门组织芯片封装与测试，封装完成及检验后再将芯片交还给客户，并向客户收取封装测试加工费。

公司生产所需原辅材料通过采购部直接向国内外供应商采购，具体为由生产计划部门根据客户订单量确定加工计划，并制定原材料采购计划与清单，采购部门根据采购计划与请购单直接向国内外供应商进行采购，并跟催物流交货进度，材料到货后由质保部门负责检验，检验合格后仓库入库并由生产领用。

3、行业情况说明：公司属于半导体集成电路（IC）产业中的封装测试行业。半导体主要包括半导体集成电路和半导体分立器件两大分支，各分支包含的种类繁多且应用广泛，在消费类电子、通讯、精密电子、汽车电子、工业自动化等电子产品中有大量的应用。集成电路产业链是半导体产业的典型代表，因为其技术的复杂性，产业机构向高度专业化转化，可细化为 IC 设计业、芯片制造业及 IC 封装测试业三个子产业群。由于具备成本和地缘优势，我国集成电路封装测试产业获得了快速发展，随着国外半导体公司的产业转移与我国半导体企业的兼并浪潮，目前我国已成为全球集成电路的主要封装基地之一，封装测试业也成为我国半导体产业的发展主体，在市场、技术、产业链等全面向国际先进水平靠拢。

（1）集成行业整体运行情况

近年来，全球集成电路行业进入调整变革时期，行业发展呈现新趋势。2011-2016 年，受 PC、智能手机、平板电脑等主要移动智能终端产品市场增长放缓等影响，全球集成电路市场增长有所放缓；2017 年因存储器芯片市场大幅增长，带动了全球集成电路销售额的快速增长趋势，全年销售额约为 3,432 亿美元，同比增长 24.03%。2018 年全球集成电路销售规模预计将超过 3,500 亿美元。从国内来看，集成电路产业作为信息产业的基础和核心组成部分，成为关系国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，在宏观政策扶持和市场需求提升的双轮驱动下，我国集成电路产业保持快速发展，产业规模从 2012 年的 2,159 亿元提升至 2017 年的 5,411 亿元，年复合增长率达到 22.9%。根据中国海关总署数据，2018 年我国集成电路出口金额 5,591 亿元，相比 2017 年同期的 4,526.2 亿元，增长 23.52%。同时，2018 年全年我国集成电路进口金额首次突破 20,000 亿元，全年进口金额 20,584.1 亿元，相比 2017 年同期的 17,610.4 亿元增长 16.89%。说明集成电

路产品仍为我国单一最大宗商品，这方面反映我国仍是世界最大的集成电路产品消费市场，终端产业需求旺盛，行业发展空间巨大，但同时也反映我国集成电路生产仍落后于市场的需求，高端产品仍有较大差距等。

（2）传感器市场情况

近年来，全球传感器市场一直保持快速增长，前瞻产研院发布的信息显示，2009 年和 2010 年增长速度达 20%以上。2011 年受全球经济下滑的影响，传感器市场增速比 2010 年下滑 5%，市场规模为 828 亿美元。随着全球市场的逐步复苏，2012 年全球传感器市场规模已达到 952 亿美元，到了 2013 年全球传感器市场规模约为 1,055 亿美元。随着经济环境的持续好转，市场对传感器的需求将不断增多，2016 年全球传感器市场规模突破 1,700 亿美元，增速达到 9.7%。截止到 2017 年末全球传感器市场规模约到 1,900 亿美元。

从国内情况来看，据前瞻产业研究院发布的数据显示，2015 年中国传感器市场规模为 995 亿元，同比增长 15%。到了 2016 年，中国传感器市场规模达到了 1,126 亿元，同比增长 13.2%。截止到 2017 年末中国传感器市场规模增长为约 1,300 亿元。预计 2018 年我国传感器市场规模将达到 1,472 亿元，未来五年(2018-2022)年均复合增长率约为 12.13%，预计到了 2022 年中国传感器市场规模将达到 2,327 亿元。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	2,272,198,541.26	2,115,220,497.28	7.42	1,934,850,691.05
营业收入	566,233,702.35	628,779,607.76	-9.95	512,390,368.91
归属于上市公司股东的净利润	71,124,803.74	95,691,736.99	-25.67	52,753,271.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,641,362.06	67,568,042.49	-63.53	33,712,978.49
归属于上市公司股东的净资产	1,883,319,656.49	1,792,290,064.36	5.08	1,674,305,721.67
经营活动产生的现金流量净额	292,157,470.13	238,024,064.86	22.74	110,533,010.91
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.42	-26.19	0.23
稀释每股收益	0.31	0.42	-26.19	0.23

(元 / 股)				
加权平均净资产收益率 (%)	3.89	5.56	减少1.67个百分点	3.18

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	141,256,966.07	136,838,291.29	147,347,323.50	140,791,121.49
归属于上市公司股东的净利润	10,457,458.81	13,760,724.41	6,185,343.22	40,721,277.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,070,243.65	7,106,356.73	3,333,800.07	9,130,961.61
经营活动产生的现金流量净额	8,954,111.10	20,774,920.44	37,639,335.32	224,789,103.27

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

☐适用 ☒不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					24, 320		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					24, 320		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中新创投		55, 048, 276	23. 51	0	质押	53, 900, 000	国有法人
EIPAT		33, 890, 269	14. 47		质押	33, 890, 269	境外法人
大基金		21, 677, 753	9. 26	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有 限公司	824, 855	5, 754, 639	2. 46	0	未知	0	未知
英菲中新	-2, 447, 000	4, 277, 819	1. 83	0	无	0	其他

GILLAD GAL-OR	-25,300	3,505,230	1.50	0	无	0	境外自然人
OmniH		2,937,855	1.25	0	无	0	境外法人
厚睿咨询		2,870,084	1.23	0	无	0	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		2,829,300	1.21	0	未知	0	未知
豪正咨询		2,427,529	1.04	0	无	0	境内非国有法人
王蔚		1,673,200	0.71	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

☐适用 ☒不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

☐适用 ☒不适用

5 公司债券情况

☐适用 ☒不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现销售收入 56,623.37 万元，同比下降 9.95%，实现营业利润 8,779.79 万元，同比下降 17.71%，实现净利润 7,112.48 万元，同比下降 25.67%。

2 导致暂停上市的原因

☐适用 ☒不适用

3 面临终止上市的情况和原因

☐适用 ☒不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

☒适用 ☐不适用

按照财政部于 2017 年 4 月 28 日制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）规定以及财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，公司调整了财务报表列报，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，主要影响如下：

资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

☐适用 ☒不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

☒适用 ☐不适用

（1）本公司本期纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例%	
			直接	间接
1	晶方半导体科技（北美）有限公司	晶方北美	100.00	—

上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”；

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本公司本期合并范围与上期相比未发生变化。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2019 年 2 月 15 日